**我们是谁**

华芯巨数（杭州）微电子有限公司汇聚国际顶尖EDA(电子设计自动化)专才，研发基于深度学习的仿真和预测模型，解决传统EDA设计流程优化问题，打造下一代EDA全流程设计云服务平台。华芯巨数聚焦EDA设计和验证工具，联合战略合作伙伴，提供制造端良率驱动的芯片设计-制造协同优化平台，创新提高并实现EDA国产替代，助力中国集成电路产业的发展。

核心成员均毕业于顶级院校，拥有世界头部半导体企业的产品研发和市场化经验。公司高速发展中，我们提供行业内有竞争力的薪酬待遇和长期激励政策，欢迎计算机电子微电子或相关电类专业，以及数学和物理基础扎实的应届毕业生加盟，公司有完善的研发培训机制和深造学习机会。

**工作地点**

公司总部位于杭州滨江高新技术开发区，在北京、武汉及美国硅谷设立研发中心，提供到美国硅谷办公室进行交流学习的机会。

**薪酬待遇**

本科和硕士20--40万，博士35--60万+

**招聘岗位**

算法工程师、C++软件开发工程师、软件测试工程师、数字后端工程师和产品应用工程师，提供实习生岗位，请发送简历到 [hr@huaxinjushu.com](file:///D%3A%5C20211210_HM_E%5C2022%E6%A0%A1%E5%9B%AD%E6%8B%9B%E8%81%98%5C%E6%A0%A1%E6%8B%9B%E5%AE%A3%E4%BC%A0PPT%5C%E5%AE%A3%E4%BC%A0%E6%9D%90%E6%96%99%5Chr%40huaxinjushu.com)。

**员工福利**

1. 免费的行业培训机制，公司报销所有与工作相关的网络课程学习费用；
2. 员工商业保险：在正常的五险一金基础上，享受公司安排的额外商业保险；
3. 年度体检、生日礼物、过节费；
4. 公司零食角提供不限量的健康零食和咖啡；
5. 每周健身活动，通讯交通补贴；
6. 年度旅游或其他形式的集体活动。

**应聘渠道**

1. 邮箱申请：简历投递[hr@huaxinjushu.com](file:///D%3A%5C20211210_HM_E%5C2022%E6%A0%A1%E5%9B%AD%E6%8B%9B%E8%81%98%5C%E6%A0%A1%E6%8B%9B%E5%AE%A3%E4%BC%A0PPT%5C%E5%AE%A3%E4%BC%A0%E6%9D%90%E6%96%99%5Chr%40huaxinjushu.com) （邮件主题: 应聘岗位+姓名+院校+专业）

2. 网页申请：<https://app.mokahr.com/m/campus_apply/huaxinjushu/36809>

3. 微信公众号申请：关注“华芯巨数“，点击校园招聘

4.联系方式：0571-85325333（陈主管）

***收到简历3个工作日内，安排面试与综合评估；面试后3个工作日内，Offer发放***



扫描左方二维码即可开始投递简历！

**附录：1）招聘岗位介绍；2）行业背景简介**

**岗位一 算法工程师**岗位职责：
1.基于已有的软件工程架构，优化或者重新设计 指定的算法功能模块，并能根据规范编写合理的单元测试；
2.基于已有的软件工程架构，根据产品需求，拓展新的算法模块，开发数值建模、优化、数据分析等算法，并能根据接口协议合理的衔接其他算法模块；
3.基于抽象化后的问题和模型，设计新的算法来解决问题，能够兼顾算法的效率和可拓展性。

岗位要求：
1.具有Linux环境下C++编程经验；
2.熟悉数据结构、动态规划、多线程及分布式计算；
3.熟悉Tcl/Python/Yaml等脚本语言编程；
4.了解商用EDA数字芯片物理设计工具及ASIC设计流程优先；
5.了解布图规划、布局布线、统计时序分析、物理综合、功耗分析、延迟计算等算法优先；
6.了解优化算法、矩阵计算、线性规划优先；
7.具有扎实的数学和物理基础，较强的分析能力和问题解决能力；
8.能够有条理的切入学习开源大型软件项目，并能有针对性的快速理解具体的算法模块；
9.较好的英语听说读写能力，能流畅的阅读英文文献。

**岗位二 C++软件开发工程师**

岗位职责：
1.EDA软件系统的人机界面开发、on-disk和in-memory数据库架构开发；
2.软件产品在云服务上的适配、联调测试和技术支持；
3.非图形界面下的script交互接口开发；
4.图形化用户操作界面的集成和维护。

岗位要求：
1.精通C/C++语言，有编程经验；
2.有复杂的系统软件开发和人机交互界面的编写经验；
3.有较强的软件API接口设计能力
4.熟悉多进程、多线程、网络编程等技术；
5.熟悉Linux下版图GUI的开发（GTK，QT）优先；
6.英语水平良好，能顺利阅读和撰写英文资料；
7.较强的沟通协作能力和自我学习能力。

**岗位三 软件测试工程师**

岗位职责：
1.负责核心软件产品的软件质量测试，包括构建和维护的云端软件质量测试系统；
2.负责编写新的测试模块，用于算法模块和功能模块的测试流程；
3.从产品经理处不断收集新功能验收后的测试样例，并能够拓展建立新的测试案例，分析和回归测试结果等。

岗位要求：
1.硕士或博士，计算机、微电子、电子或其他电类专业；
2.能够熟练使用shell, python, Tcl/Tk或其他脚本语言；
3.能够学习和了解云服务架构的DevOps开源工具，并把最新的DevOps工具应用到工作流程；
4.了解数字芯片设计或者ASIC后端设计流程优先；
5.能够读写英语文档，并流畅的阅读英文技术类博客。

**岗位四 产品应用工程师**

岗位职责：
1.根据提供的产品规划SOW（Statement of Work）文档，撰写清晰的功能需求文档和功能验收流程；
2.配合相关功能的算法工程师和软件工程师，优化功能需求文档；
3.验收算法工程师和软件工程师交付的开发结果，并撰写验收报告，提出优化需求;
4.配合客户，使用公司的数字ASIC后端设计产品完成客户需求，查找产品功能缺陷，撰写产品功能优化的需求文档；
5.根据验证结论和行业经验，不断思考和探索新的产品功能需求。

岗位要求：
1.有数字后端设计相关的经验优先；
2.有使用主流芯片数字设计工具的经验优先；
3.有大型软件项目的产品设计经验，参与过研究机构的大型软件科研项目者优先；
4.熟练使用Tcl，Python，Yaml等脚本建立自动化流程；
5.有意愿在后端设计上不断的深入学习和研究；
6.责任心强，有较好的沟通协调能力；
7.较好的英语听说读写能力，能流畅的阅读英文文献。

**岗位五 数字后端工程师**

岗位职责：

1、完成数字设计中模块和芯片级别的物理实现，包括综合，布局布线，静态时序分析和功耗分析；

2、优化工具flow流程，指导研发的开发方向。

任职要求：

1、本科及以上学历，电子工程/微电子/通信/自动化等相关专业；

2、掌握电路分析，模拟电路，数字电路等专业基础知识；

3、熟悉RTL到GDSII所有或部分阶段的后端设计工作，包括以下步骤：Floorplanning、Power Plan、CTS 、Timing Analysis 、IR-Drop Analysis，crosstalk Analysis，Formal Verification, STAR\_RC ，STA and DMSA；

4、熟悉Hierarchical design flow, 有top level经验者优先；

5、熟悉使用tcl或python进行编程；

6、熟悉Linux开发环境，熟练使用常用命令，能够编写简单的shell脚本；

7、具有基本英语听说读写能力，有较强的学习能力和团队协作精神。

加分项：

有芯片设计实习经验，或使用过icc，icc2，innovus等EDA工具。

**行业背景简介**

电子设计自动化（EDA）指利用软件完成大规模集成电路的设计方式，融合了图形学、计算数学、微电子学及人工智能等技术，贯穿于集成电路设计、制造、封测等环节。EDA 软件是设计和制造芯片不可或缺的核心工业软件，是当前国内集成电路产业链里急需自主创新的关键技术。

* **摩尔定律带动EDA工具升级-** IC基本元件更小更快更省电，芯片复杂程度和集成度不断提升。台积电将于2022年实现３nm芯片量产；IBM宣布成功开发２nm制程技术；
* **芯片功能多样化全面化-** SoC无处不在，5G芯片，汽车自动驾驶芯片，人工智能芯片等新型应用芯片层出不穷，设计复杂度大幅上升；
* **制程工艺进步-** 光刻，刻蚀等技术突飞猛进，尺寸控制精益求精，对上游工具的准确率要求日增。设计与工艺的综合优化势在必行；
* **计算技术突破及AI的应用-** GPU加速，云计算，超级计算等，提升计算能力，加强物理模拟，改进优化算法，能更准更快地得到更好的设计。机器学习的应用提供更smart的设计过程，加快设计步骤，减短反馈时间，拓展优化空间。